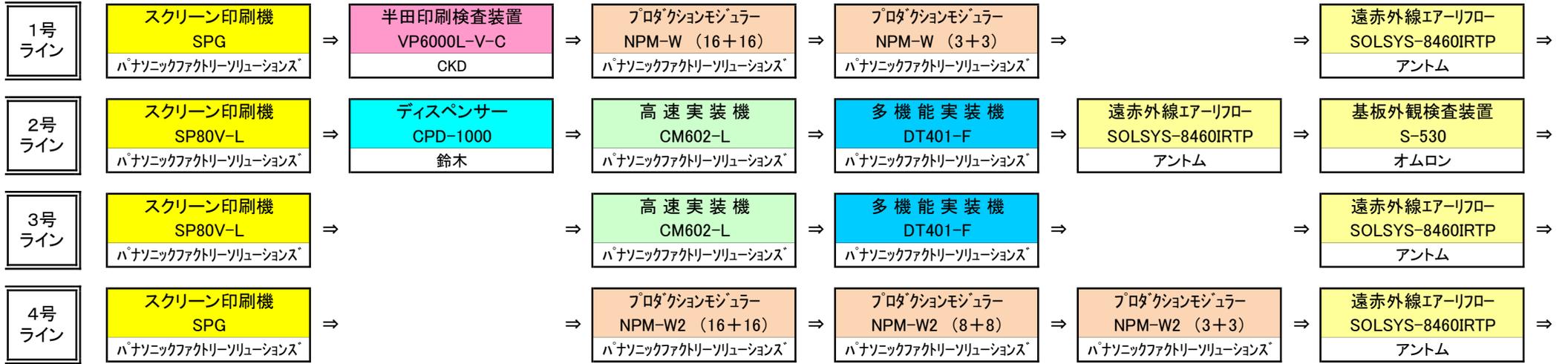


試作基板・多品種少量生産から量産までのご要望にお応えする基板面実装ラインレイアウト

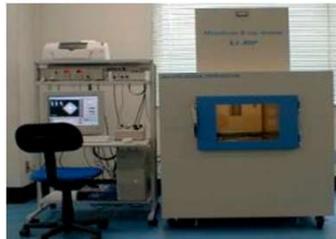


(オムロン製/S-530)

◎ 高精度、高密度実装を実現
全ラインとも微小チップ(1005サイズチップ等)実装及びBGA/CSP部品実装に対応
(※全ラインとも、0603サイズチップの実装対応可能、0402サイズは実績なし)

◎ 基板外観検査装置は、オフラインにて検査対応
※他、マランツ社製の卓上型基板外観装置での検査対応も(長尺基板に対応)

◎ BGA/CSP実装を保証するための関連設備
◇ 部品実装後の品質保証・不良解析のためのX線透視装置
(ユニハイトシステム社製/XJ-80P)



(マランツエレクトロニクス製/U22XFMA-650)



(オムロン製/VT-RNS II)